

DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
×	0.200 mm		297	
+	0.800 mm		33	
₩	1.100 mm		32	
ъ	1.200 mm		23	
0	1.300 mm		2	NON-PLATED
Δ	1.600 mm		2	
٥	2.700 mm		5	
TOTAL			394	

PCB STACK-UP 4 LAYERS_2_SMD_UP



MATERIALE

TIPOLOGIA CIRCUITO	SUPPORTO	SPESSORE RAME
☐ MONOFACCIA	☐ FR2	X LATI ESTERNI 35u
DOPPIA FACCIA	X FR4	LATI INTERNI
MULTISTRATO	□ ALTRO	SPESSORE SUPPORTO
N°LAYERS 4		1.6 mm

TRATTAMENTI

L M

NOTE PARTICOLARI

TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO ESSERE METALLIZATI

RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u				
☐PLACC.ELETT. SURFUSOS	Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u			
□PLACC.ELETT. RIFUSO S	Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u			
RAME PASSIVATO	MHOT AIR LEVELING			
□DORATURA(D=140±vPN)	0.3u0.6u1,0u1,3u2,0u			
□BISELLATURA	NUMERO DEI CONTATTI			
DEPOSITO DI GRAFITE	NUMERO DEI CONTATTI			

SOLDER RESIST	SERIGRAFIA
SERIGRAFICO Sp.	XLATO COMP.COLORE BIANCO
XFOTOGRAFICO Sp. 13-100u	XLATO SALD. COLORE BIANCO
DCOVER LAYERSD 25-76H	

COVER LAYERSp. 25-76u						
	TABELLA DEI FORI CON LAVORAZ. PARTICOLARI			FILES DI DOCUN ASSOCIATI PER LA		
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	22-302-0.BOT	
Α				LAYER TOP	22-302-0.TOP	
В				LAYER PWR		
С				LAYER GND 💢 22-302-0.G		
D				SERIG. BOT 💢 22-302-0.9		
Е				SERIG. TOP 💢 22-302-0.		
F				LAYER IN1 🔀 22-302-0.IN		
G						
Н		LAYER IN3				

_		
,	LAYER BOT	X 22-302-0.BOT
	LAYER TOP	X 22-302-0.TOP
	LAYER PWR	
	LAYER GND	💢 22-302-0.GND
	SERIG. BOT	💢 22-302-0.SSB
	SERIG. TOP	X 22-302-0.SST
	LAYER IN1	💢 22-302-0. I N1
	LAYER IN2	
	LAYER IN3	
	LAYER IN4	
	RESIST BOT	X 22-302-0.SMB
	RESIST TOP	💢 22-302-0.SMT
	PAST BOT	💢 22-302-0.SPB
	PAST TOP	X 22-302-0.SPT
	LAYER FOR.	X 22-302-0.DRL
	DRILL CHART	
	DRILL TAPE	X 22-302-0.TAP
	MECC.DRW.	💢 22-302-0.DWG

А3

MATERIALE	TRATTAMENTO		METALTRONICA S.r.I.	
VEDI TABELLA	VEDI TABELLA		METALTRONICA S.I.I.	
TOLL.GENERALE	DISEGNATORE	DATA	TITOLO	
±0.2		17/01/23	PF 22-302-0	
NOME FILE	REVISIONE	DATA	COD.INTERNO SCALA	
PF22-302-0.DWG	0		F.S.	